

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-11

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	<p>鑫元基金、华泰柏瑞基金、朱雀基金、国金基金、华富基金、华宝基金、趣时资产、中银基金、长江养老、国泰基金、银华基金、东北证券、华泰资产、太平养老、华商基金、国投瑞银、艾希资本、CPIC、Pinpoint Asset Management、上海乘是资产、上海从容投资、上海仙人掌资产、上海兆顺私募、上海六禾投资、上海冲积资产、上海勤辰私募、上海南土资产、上海合远私募、上海同犇投资、上海和谐汇资产、上海域秀资产、上海复胜资产、上海彤源投资、上海微积分私募、上海汐泰投资、上海浦泓投资、上海海宸投资、上海煜德投资、上海玖鹏资产、上海磐厚投资、上海聚鸣投资、上海贵源投资、上海运舟私募、上海途灵资产、上海长见投资、上海阿杏投资、世嘉控股集团、东吴人寿、东方马拉松投资、中信保诚基金、中信建投基金、中信证券、中国人保资产、中广云投资、中欧基金、中海基金、中银国际证券、交银施罗德基金、信达澳亚基金、全天候私募、兰慕资产、兴业基金、农银汇理基金、准锦投资、北京水印投资、北京源益私募、北京秋收私募、北京诚旸投资、北京遵道资产、北京金百镭投资、华创证券、华夏久盈资产、华夏基金、华鑫证券、南方基金、博睿乾远、博道基金、友邦人寿、国信证券、国华兴益保险资产、国泰君安证券、国联安基金、圆信永丰基金、基石资产、大成基金、天治基金、太平资产、宁银理财、富国基金、富安达基金、富达基金香港、平安基金、广东莲花私募、德邦证券、惠升基金、新华资产、易方达基金、杭州巨子私募、正心谷创新资本、民生通惠资产、汇丰晋信基金、汇添富基金、沅京资本、泰信基金、测度投资、浙江四叶草资产、浦银安盛基金、海富通基金、深圳河床资产、淳厚基金、湘财基金、甬兴证券、福泽源私募、翊安投资、西南证券、西安清善咨询、西藏合众易晟投资、西部证券、诺德基金、财通基金、财通证券资管、鑫巢资本、银河基金、锐方上海私募、长信基金、长江证券资管、长盛基</p>

	金、鹏扬基金、博时基金、金信基金、红土创新基金、前海联合基金、生命保险资产、国任保险、海南今芯基金、辰禾投资、亘泰投资、东方财富证券
上市公司接待人员	证券事务主管：阳佩琴；投资者关系经理：邹云合
时间	2026年5月19日-21日
地点	华福证券策略会、华创证券策略会、东方财富证券策略会、机构投资者所在地
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 2026 年一季度经营业绩情况。</p> <p>2026 年一季度，公司实现营业收入 65.96 亿元，同比增长 37.90%，归母净利润实现 8.50 亿元，同比增长 73.01%，扣非归母净利润累计实现 8.49 亿元，同比增长 75.04%。</p> <p>上述变动主要得益于 AI 算力升级及存储市场需求增长，公司产品结构优化，400G 以上高速交换机、光模块占比同比提升，数据中心收入同比增长，产能利用率提升，叠加广州工厂爬坡顺利，推动营收和利润双增。</p> <p>Q2、请介绍 2026 年一季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。</p> <p>公司在 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2026 年一季度，PCB 通信、数据中心占 PCB 收入占比环比增加；受消费周期影响，汽车电子收入占比有所下降，其余占比维持稳定。</p> <p>Q3、请介绍 2026 年一季度封装基板业务经营拓展情况。</p> <p>公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的封装基板技术能力。2026 年一季度，受益于处理器芯片类封装基板需求增加、存储类封装基板收入持续增长，公司封装基板业务收入占比环比提升。</p> <p>Q4、请介绍公司近期产能利用率情况。</p>

近期公司综合产能利用率处于高位，其中公司 PCB 业务受益于 AI 算力基础设施硬件相关产品需求的增长，工厂产能利用率维持高位；封装基板业务因存储类、处理器芯片类基板需求拉动，工厂产能利用率延续 2025 年四季度以来的较高水平。

Q5、请介绍公司南通四期及泰国项目爬坡进展。

泰国工厂与南通四期项目于 2025 年下半年顺利连线投产，目前产能正稳步爬坡。因为该项目仍处于爬坡早期阶段，在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，但因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高，会对公司利润产生一定影响。公司将持续加强内部能力建设，提前做好潜在难点识别，加快重点客户项目引入进程，尽可能缩短爬坡周期，为业务的进一步拓展提供支持。

Q6、请介绍公司广州封装基板项目爬坡进展。

2025 年以来，公司广州封装基板项目产品线能力持续提升，其中 BT 类封装基板产能爬坡稳步推进，FC-BGA 类封装基板已实现 22 层及以下产品量产，24 层及以上产品技术研发及打样工作按期推进。

Q7、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2026 年继续受到大宗商品价格变化的影响，覆铜板、铜箔、金盐等关键原材料价格同步上行，对公司盈利水平构成一定影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

Q8、请介绍公司 2026 年资本开支的方向。

2026 年公司资本开支主要聚焦 PCB 与封装基板业务，重点投向无锡高速高密、高多层电子电路产品项目、广州封装基板工厂建设，以及南通四期、泰国工厂项目后续款项支付；同时适时开展技术改造，打开瓶颈、释放产能。

Q9、请介绍公司 PCB 业务在 AI 算力方面的布局情况。

伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，电子产业对于高算力和高速网络的需求

	<p>日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。2024 年以来，公司 PCB 业务在高速交换机、光模块、AI 加速卡、服务器等领域的 PCB 产品需求增长均受益于上述趋势。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>